

**H3C S12500交换机CMW520-R1230
版本发布**

一、使用范围及配套说明：

H3C S12500交换机CMW520-R1230版本对外正式发布，不受限使用。

产品系列	H3C S12500系列路由交换机
型号	S12508/S12518
内存需求	主控板最小1G，接口板最小512M
FLASH需求	最小128M (备注：必须配备H3C认证通过的CF卡，CF卡最小256M)
BootROM版本号	主控板BootROM 1.09及以后版本 接口板、OAM CPU BootROM 1.09及以后版本 网板BootROM 1.07及以后版本
MBUS版本号	109及以后版本，见注⑥
风扇版本号	102及以后版本
目标文件名称	S12500-CMW520-R1230.bin (31,921,640字节)
iMC版本号	iMC EAD 3.60-C6205 iMC MVM 3.50-E5301 iMC NTA 3.20-R0604 + P01 iMC PLAT 3.20-R2606 + P07 iMC QoSM 3.20-R0604 iMC UAM 3.60-C6205 iMC UBA 3.20-R0604 + P01
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6205
WEB版本号	无
备注	无

二、增减特性说明：

新增特性：无

三、相比前一版本解决的问题说明：

解决了以下缺陷：

1. HSD62482

首次发现版本：S12500-CMW520-R1228

问题产生条件：

三层组播入接口包含聚合端口，并且聚合端口在单框包含超过一个端口。

问题现象：

当前版本需要支持三层组播入接口包含聚合端口的优化功能。

2. HSD62501

首次发现版本：S12500-CMW520-R1228

问题产生条件：

当前版本最多只支持200个聚合组，需要放大支持240个聚合组。

问题现象：

当前版本最多只支持200个聚合组，需要放大支持240个聚合组。

3. HSD62247

首次发现版本：S12500-CMW520-R1228

问题产生条件：

在设备双主控板的时候，主用主控板稍微拔出又再插入。

问题现象：

小概率出现双主用主控板的现象。

4. HSD62329

首次发现版本：S12500-CMW520-R1228

问题产生条件：

在端口上插入使用非定制光模块或者旧的定制光模块。

问题现象：

对端口进行shutdown/loopback等操作的时候，会打印I2C访问失败的信息。

5. HSD62471

首次发现版本：S12500-CMW520-R1228

问题产生条件：

三层VLAN接口上配置有策略路由PBR，同时设备上存在缺省路由。

问题现象：

存在缺省路由的条件下，导致PBR失效后报文没有精确匹配路由转发（走缺省路由）

。

6. HSD60295

首次发现版本: S12500-CMW520-R1228

问题产生条件:

两个IRF组(四台设备组成两个堆叠系统)通过跨框聚合链接。

问题现象:

两个IRF组同时使能LACP MAD时, MAD不生效。

7. HSD61657

首次发现版本: S12500-CMW520-R1228

问题产生条件:

当存在VRRPE IP地址冲突的情况下, VRRPE Master设备会应答免费ARP。

问题现象:

应答免费ARP的MAC地址错误导致下挂设备的ARP学错, 无法PING通VRRPE IP地址

。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S12500-CMW520-R1230 版本说明书》

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 4008100504/8008100504